
调试变得日益严峻

By Dr. Neal Stollon, Principal Engineer for HDL Dynamics

对于复杂硅系统来说，当仿真和其它多种混合分析都已经核实，芯片送到流片厂的时候，设计团队会松一口气。但是参与其中的有经验的工程师知道，在这个节点上仅仅完成了一半的工作。下一个，可能也是验证分析最关键的阶段，发生在当芯片从流片厂回来并且封装在测试板上的时候。在那个时候，为了使第一次流片的芯片工作，他们开始费力并且屡屡受挫的工作。团队的“调试”通常集中在嵌入芯片连同软件/硬件集成的所有调整过程，以及确保系统可以工作在指定的环境和界面的验证工作。这一领域有其自身独特的挑战。在最近几年中，“可调试性设计”团队一直致力于定义相关技术和实现途径，使得设计者可以用来提高可见度并用来控制他们的硅产品的测试分析。

本篇文章的全文请参阅：

<http://www.chipdesignmag.com/display.php?articleId=2013&issueId=26>